

■APP社製 (ArP[®])大気圧プラズマ処理装置

- 真空設備を必要とせず大気圧で処理が可能です -

● 特長

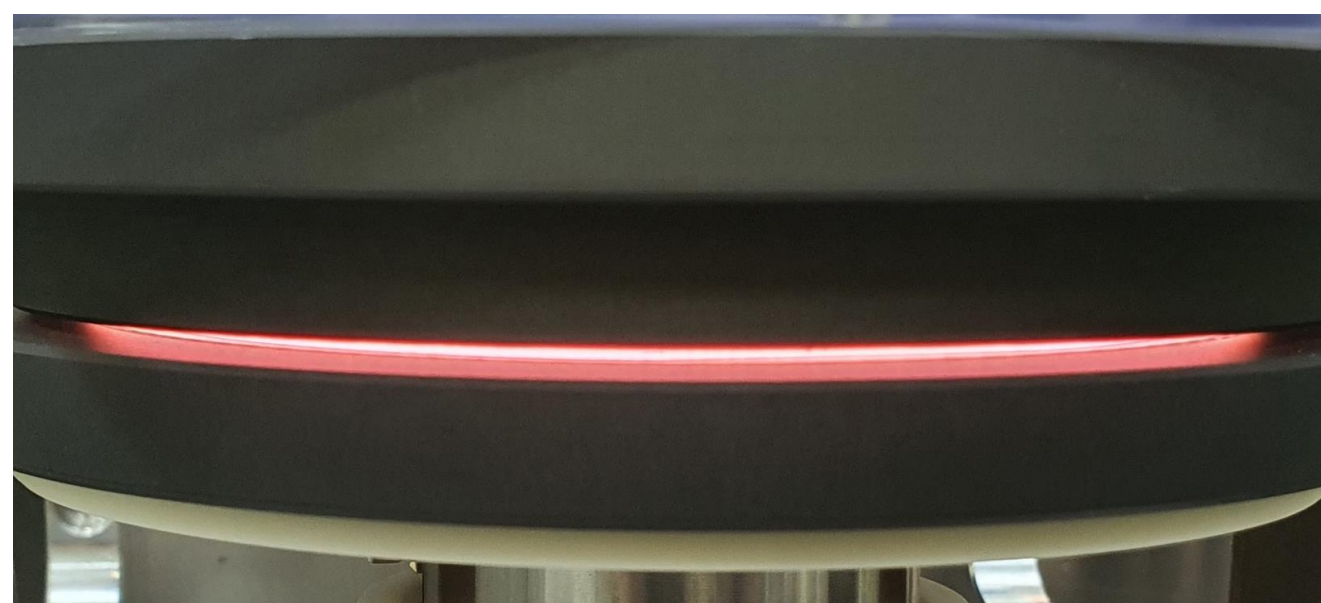
- 大気圧環境下で使用できるため生産性が高い
- 省スペースでインライン化・大面積化が容易
- 付帯設備が少なくイニシャルコストを削減
- 不活性ガスの使用量が少なくランニングコストを削減
- プラズマの低出力化により対象物へのダメージが最小限
- 「ダイレクトプラズマ方式」の採用で圧倒的な低電圧を実現
- シンプルなプラズマヘッド構造により安定したグロープラズマを実現

● 外観



● 用途

ウェーハプロセス



- ウェーハクリーニング
- フォトマスククリーニング
- 除電
- 有機物除去
- 表面活性化

パッケージプロセス



- ダイボンディング
- ワイヤボンディング
- PCBボンディング
- ダイレクトボンディング
- バンプボンディング

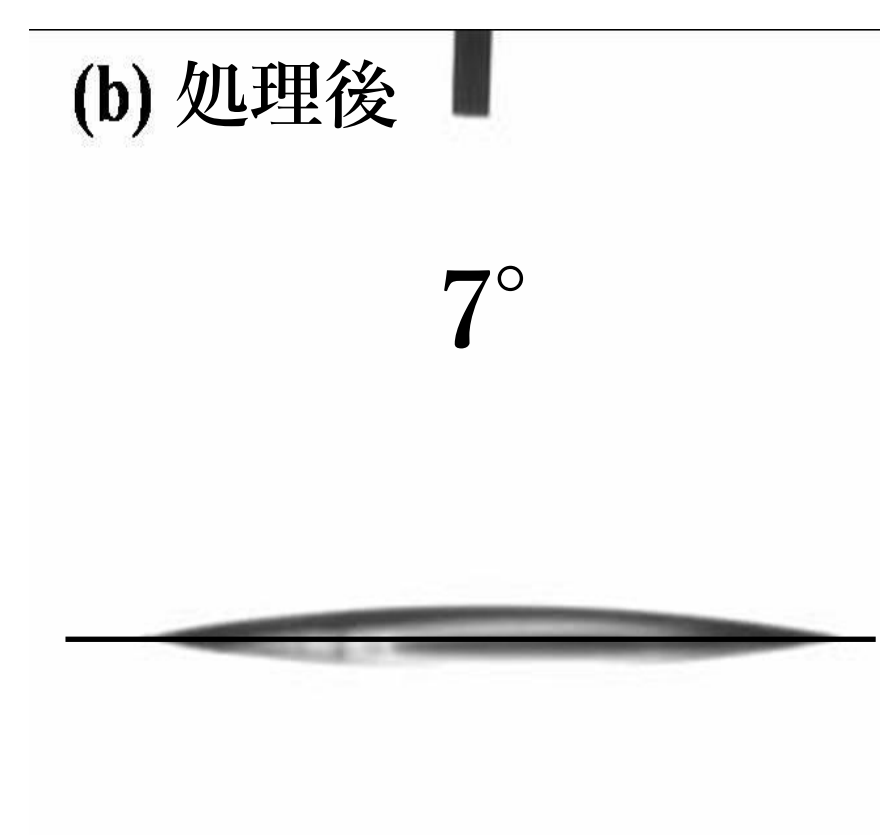
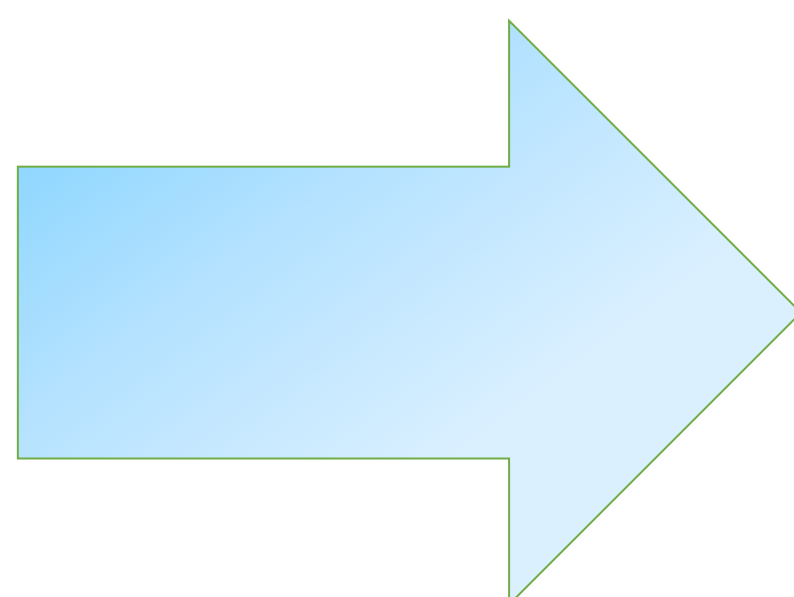
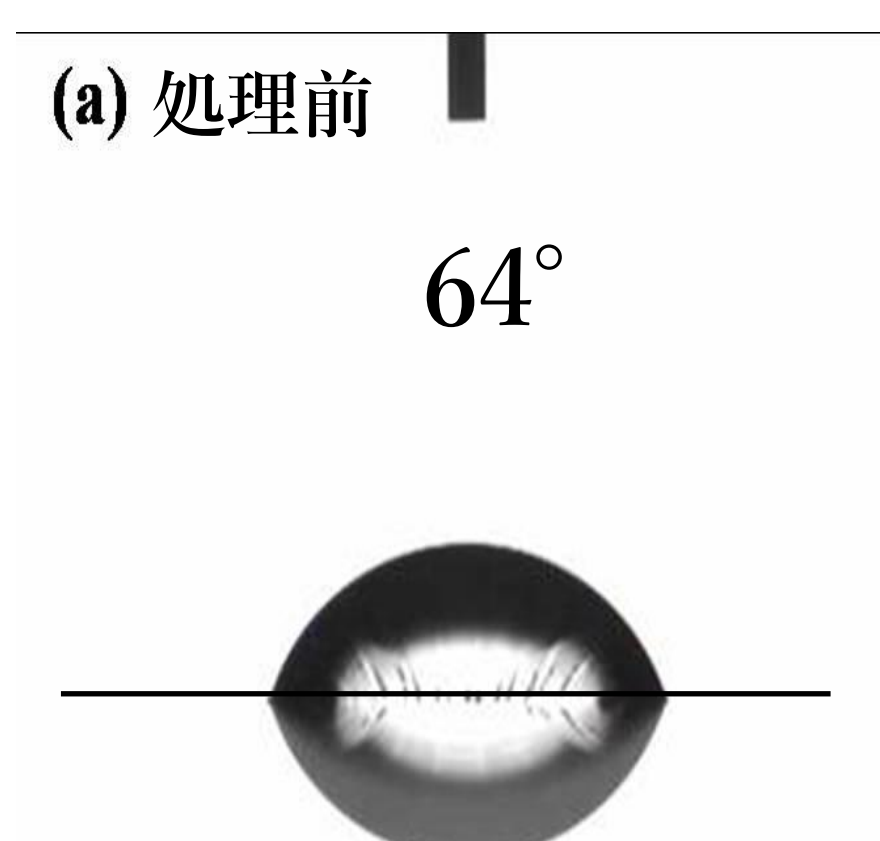
材料



- コーティング用
- メッキ用
- 印刷用
- 接合用
- ラミネート用

● 大気圧プラズマ効果

■Lead FrameとBGA有機基板へのプラズマ効果データ（接触角比較）



[実験条件]

処理速度：100mm/秒、酸素流量：20sccm、アルゴン流量：4L/min、プラズマ入力電力：100W

● 製品バリエーション



テーブルタイプ



コンベアタイプ



スキャンタイプ

● 装置仕様

	テーブルタイプ	コンベアタイプ	スキャンタイプ
型式	MyPL Auto-200	ILP-500C	ILP-350S
入力電源	AC220V,50/60Hz	AC220V,50/60Hz	AC120V,50/60Hz
RF出力	300W	600W	600W
周波数	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz
キャリアガス	Ar	Ar	Ar
反応ガス	O ₂ ,N ₂	O ₂ ,N ₂	O ₂
外気温	0~50℃	0~50℃	0~50℃
湿度	0~90℃	0~90℃	0~90℃
冷却タイプ	空冷	水冷	空冷
処理幅	200mm (X) × 250mm (Y)	500mm (X) × 1500mm (Y)	400mm (X)
処理スピード	100mm/sec	100mm/sec	100mm/sec
動作方法	DCサーボ&ステッピング	ベルトコンベアー	DCサーボ&ステッピング
インターフェイス	タッチスクリーン	タッチスクリーン	タッチスクリーン
制御方法	PLC	PLC	PLC
外形寸法	620 (L) × 700 (W) × 400 (H)	700 (L) × 1500 (W) × 1100 (H)	850 (L) × 1460 (W) × 1800 (H)
重量	65kg	150kg	400kg

株式会社クリエイティブテクノロジー
〒213-0034
神奈川県川崎市高津区上作延1-11-33
TEL 044-853-1757 FAX 044-861-5096
e-mail : info@createch.co.jp

-最新情報はWebサイトにて公開中-
<https://creative-technology.co.jp/>

